

粤芯半导体及燧原科技 IPO 即将上会, AI 算力建设持续推进

——电子行业跟踪报告

强于大市 (维持)

2026 年 06 月 15 日

行业核心观点:

上周申万电子指数下跌 1.87%，跑输沪深 300 指数，跑赢创业板指数。燧原科技、粤芯半导体拟于本周进行 IPO 上会，二者分别系优质 AI 芯片公司、晶圆代工公司，受益于 AI 产业发展浪潮。上周 DRAM 市场现货情绪有所回暖，受 DDR5、DDR4 强劲需求影响，DDR3 需求亦有提振，同时 SK 海力士采购升级版键合设备，HBM4 量产提速，均表明 AI 算力、存力建设仍在加速推进。此外，随着我国更多优质半导体领域公司上市，投融资与产能扩充有望拉动上游半导体设备及材料需求。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如 PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备及材料、先进封装等需求，建议关注 PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

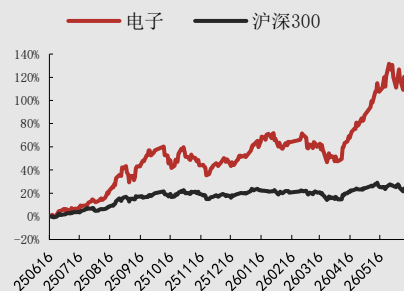
投资要点:

产业动态: (1) **存储**，根据 TrendForce 集邦咨询最新数据，DRAM 方面，DDR5 需求尤为强劲，而 DDR4 供应紧张且价格持续高企，促使部分买家降级至 DDR3，这也推高了 DDR3 的价格。NAND 闪存方面，在 2026 年第二季度合约价格上涨后，现货价格已趋于稳定，但整体交易活动依然低迷。(2) **存储**，SK 海力士正式向韩美半导体订购价值 442 亿韩元（约合 2900 万美元）的第六代高带宽内存“HBM4”制造设备，标志着随着 HBM4 量产的正式启动，其相关设备投资已全面展开。(3) **晶圆代工**，根据 TrendForce 集邦咨询数据，除了 AI HPC 与相关周边订单仍如火如荼出货外，第一季基于 TV、PC/NB 等供应链提前生产出货、并提高周边 IC 库存水位措施，晶圆代工厂商陆续接获客户提前生产或加单订单。尽管仍受智能手机生产淡季影响，但淡季因素基本与供应链提前拉货所相抵，整体营运表现淡季不淡，第一季全球前十大晶圆代工产值季增 3.7%至 479.5 亿美元，再创新高。(4) **半导体**，6 月 8 日，沪深交易所网站显示，燧原科技科创板 IPO 申请、粤芯半导体创业板 IPO 申请将于 6 月 15 日上会。燧原科技是我国云端 AI 芯片领军企业之一，自研迭代了四代架构 5 款云端 AI 芯片，构建了 AI 芯片、AI 加速卡及模组、智算系统及集群和 AI 计算及编程软件平台的完整产品体系。粤芯半导体是一家致力于为境内外芯片设计企业提供 12 英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业。

行业估值: 从估值情况来看，截至 2026 年 6 月 14 日，SW 电子板块 PE (TTM) 为 101.03 倍，2019 年至 2026 年 6 月 14 日 SW 电子板块 PE (TTM) 均值为 55.37 倍，行业估值高于近年中枢水平。

风险因素: 中美科技摩擦加剧；AI 应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源：聚源，万联证券研究所

相关研究

SK 海力士计划扩大晶圆产能，英伟达 Vera Rubin 即将全面投产

华为发布“ τ 定律”，长鑫科技 DRAM 市场份额排名前列

AI 算力、存力加速建设，推动 SW 电子行业业绩向好

分析师:

夏清莹

执业证书编号: S0270520050001

电话: (0755) 8322 3620

邮箱: xiaqy1@wlzq.com.cn

分析师:

陈达

执业证书编号: S0270524080001

电话: 13122771895

邮箱: chenda@wlzq.com.cn

正文目录

1 行业周观点	3
2 市场行情回顾	3
3 产业动态	5
3.1 存储: DDR4 紧缺局面蔓延至 DDR3, NAND 价格止跌回稳	5
3.2 存储: SK 海力士采购升级版键合设备, HBM4 量产提速	5
3.3 晶圆代工: 第一季全球前十大晶圆代工产值季增 3.7%至 479.5 亿美元	5
3.4 半导体: 粤芯半导体及燧原科技 IPO 即将上会	5
4 风险提示	6
 图表 1: 申万一级周涨跌幅 (%)	 3
图表 2: 申万一级年涨跌幅 (%)	4
图表 3: 申万电子板块估值情况 (2019 年至 2026 年 6 月 14 日)	4

1 行业周观点

燧原科技、粤芯半导体拟于本周进行IPO上会，二者分别系优质AI芯片公司、晶圆代工公司，受益于AI产业发展浪潮。上周DRAM市场现货情绪有所回暖，受DDR5、DDR4强劲需求影响，DDR3需求亦有提振，同时SK海力士采购升级版键合设备，HBM4量产提速，均表明AI算力、存力建设仍在加速推进。此外，随着我国更多优质半导体领域公司上市，投融资与产能扩充有望拉动上游半导体设备及材料需求。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

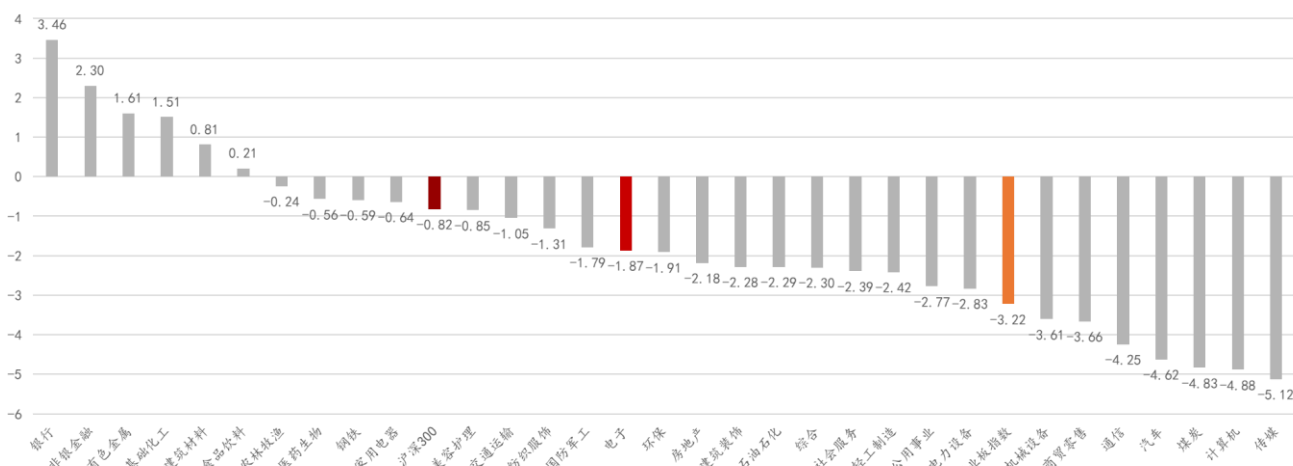
中长期视角，我们建议把握AI算力建设和终端创新的投资机遇。AI浪潮持续推进，算力建设方兴未艾，算力关键硬件环节需求旺盛，存储、PCB等正处于景气扩张周期；同时，AI手机、AI PC、AI眼镜有望加速渗透传统消费电子市场，随着大厂持续发布新品及应用生态完善，AI创新终端市场规模有望持续增长。

- 1) **存储**，建议关注景气周期下存储原厂业绩增长，以及产品涨价浪潮下存储模组厂商盈利修复，资本开支提升背景下上游半导体设备需求提振带来的投资机遇。
- 2) **PCB**，建议关注在HDI、多层板等高端PCB领域前瞻布局的PCB龙头厂商，以及景气扩张周期下，上游设备及材料需求提振带来的投资机遇。
- 3) **AI创新终端**，建议关注苹果、Meta等龙头厂商新品发布推动品牌出货提升，并提振产业链需求带来的投资机遇。

2 市场行情回顾

上周，申万电子行业跑输沪深300指数，跑赢创业板指数。上周申万电子指数下跌1.87%，在31个申万一级行业中排第15，沪深300指数下跌0.82%，创业板指数下跌3.22%，申万电子跑输沪深300指数1.05个百分点，跑赢创业板指数1.35个百分点。

图表1：申万一级周涨跌幅（%）

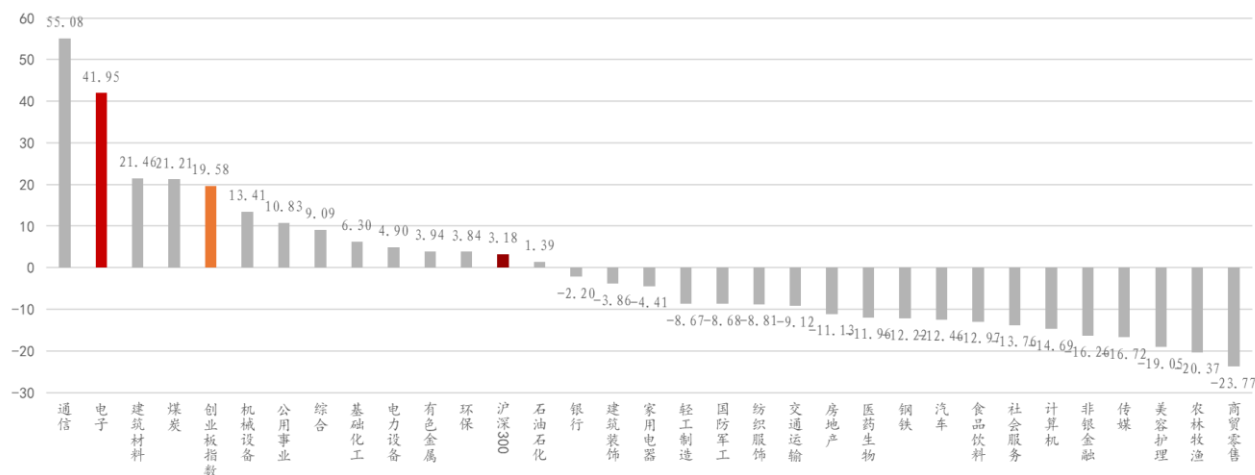


资料来源：iFinD，万联证券研究所

2026年初以来，申万电子行业跑赢沪深300指数和创业板指数。2026年初至2026年6月

14日，沪深300指数上涨3.18%，创业板指数上涨19.58%，申万电子行业上涨41.95%，在31个申万一级行业中排名第2位，跑赢沪深300指数38.77个百分点，跑赢创业板指数22.37个百分点。

图表2：申万一级年涨跌幅（%）



资料来源：iFinD，万联证券研究所

申万电子行业估值略高于近年中枢。从估值情况来看，截至2026年6月14日，SW电子板块PE (TTM) 为101.03倍，2019年至2026年6月14日SW电子板块PE (TTM) 均值为55.37倍，行业估值高于近年中枢水平。基于AI算力加速建设、半导体产业链景气复苏等趋势利好，我们认为板块估值仍有上行空间。

图表3：申万电子板块估值情况（2019年至2026年6月14日）



资料来源：iFinD，万联证券研究所

3 产业动态

3.1 存储：DDR4 紧缺局面蔓延至 DDR3，NAND 价格止跌回稳

根据TrendForce集邦咨询最新数据，DRAM方面，DDR5需求尤为强劲，而DDR4供应紧张且价格持续高企，促使部分买家降级至DDR3，这也推高了DDR3的价格。NAND闪存方面，在2026年第二季度合约价格上涨后，现货价格已趋于稳定，但整体交易活动依然低迷。近两周DRAM现货市场整体报价维持上涨格局。其中，DDR5颗粒询单活跃且买方追价意愿提升；另一方面，由于DDR4颗粒供不应求且价格居高不下，部分需求被迫向下寻求DDR3颗粒替代，进一步持续推升DDR3颗粒价格。主流颗粒DDR4 1Gx8 3200MT/s在本周（6/3-6/9）的价格涨幅为2.22%（由US\$35.12上涨至US\$35.90）。NAND市场方面，近期受2026年第二季度合约价上涨提振，本周NAND现货价格止跌回稳，不过受到消费市场需求疲软，整体交易依旧平淡。本周（更新至6/8）512Gb TLC Wafer现货价格下跌0.22%，报价来到每颗US\$20.64。（来源：TrendForce集邦咨询）

3.2 存储：SK海力士采购升级版键合设备，HBM4 量产提速

SK海力士正式向韩美半导体订购价值442亿韩元（约合2900万美元）的第六代高带宽内存“HBM4”制造设备，标志着随着HBM4量产的正式启动，其相关设备投资已全面展开。根据日前披露的销售与供应合同，SK海力士此次采购的是用于HBM4制造的升级版“TC Bonder 4.5 Griffin”设备。该笔订单金额占韩美半导体去年总营收（5766亿韩元）的7.66%。合同期限从即日起至9月2日。TC键合机是HBM制造工艺中的核心设备，它利用热力和压力将多个DRAM芯片垂直堆叠在一起，决定了堆叠精度和良率，被认为是HBM生产竞争力的关键因素。作为占据HBM市场首位的存储巨头，SK海力士拥有业内数量最多的HBM键合设备。SK海力士HBM最大客户的英伟达CEO黄仁勋近日访韩时明确表示：“三大存储厂商均已通过HBM4的质量测试，并正在推进量产。”他还表示，SK海力士过去是英伟达最大的内存合作伙伴，未来也将继续保持这一地位，不会改变。SK海力士近期已向主要合作企业分享了其在2030年至2031年间将DRAM晶圆产能扩大至目前两倍水平的中长期扩产计划：将目前每月约55万张（包含中国无锡工厂约20万张产量）的DRAM月产能，提升至2030年的100万张左右。此次扩产将高度集中于龙仁半导体集群。（来源：CFM闪存市场）

3.3 晶圆代工：第一季全球前十大晶圆代工产值季增 3.7%至 479.5 亿美元

根据TrendForce集邦咨询数据，除了AI HPC与相关周边订单仍如火如荼出货外，第一季基于TV、PC/NB等供应链提前生产出货、并提高周边IC库存水位措施，晶圆代工厂商陆续接获客户提前生产或加单订单。尽管仍受智能手机生产淡季影响，但淡季因素基本与供应链提前拉货所相抵，整体营运表现淡季不淡，第一季全球前十大晶圆代工产值季增3.7%至479.5亿美元，再创新高。

展望第二季，TV、PC/NB ODM与品牌等提前备货红利将再延续约一季，加上智能手机陆续进入新机备货周期，晶圆代工厂商基于产能利用率回升，陆续向客户表达下半年晶圆代工价格将调涨的意愿，将带动部分制程晶圆代工价格触底反弹，也进一步刺激客户提前备货动机。同时，AI相关先进制程与Power产品需求成长动能优于预期，也带动产业订单外溢与产能排挤效应。TrendForce集邦咨询预估，全球前十大晶圆代工第二季产值将再创高峰，且季增幅较前季明显加速。（来源：TrendForce集邦咨询）

3.4 半导体：粤芯半导体及燧原科技 IPO 即将上会

6月8日，沪深交易所网站显示，燧原科技科创板IPO申请、粤芯半导体创业板IPO申请将于6月15日上会。燧原科技创立于2018年3月。成立以来，公司自研迭代了四代架构

5款云端AI芯片，构建了AI芯片、AI加速卡及模组、智算系统及集群和AI计算及编程软件平台的完整产品体系，目前已成为我国云端AI芯片领军企业之一，形成了芯片及硬件、软件及编程平台和算力集群方案三大类，全方位、立体化的核心技术体系。经营方面，燧原科技营业收入从2023年的3.01亿元增至2025年的9.9亿元。今年前3月，公司营业收入为2.87亿元，同比增长1474.85%。净利润方面，燧原科技2023年、2024年、2025年归母净亏损分别为16.65亿元、15.10亿元、11.64亿元，亏损规模逐年收窄，但尚未实现盈利。今年前3月，公司尚未盈利，归母净亏损为4.44亿元，未弥补亏损进一步增加，期末股东权益同比2025年期末金额下降。此次科创板IPO，燧原科技拟募集资金约60亿元，拟投资基于五代AI芯片系列产品研发及产业化项目、基于六代AI芯片系列产品研发及产业化项目、先进人工智能软硬件协同创新项目。

粤芯半导体是一家致力于为境内外芯片设计企业提供12英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业。公司目前拥有两座12英寸晶圆厂，分别为第一工厂（粤芯一、二期）和第二工厂（粤芯三期），规划产能合计为8万片/月，截至2025年末已实现产能6.33万片/月。目前，公司已启动建设一条规划产能为4万片/月的12英寸集成电路数模混合特色工艺生产线，即第三工厂（粤芯四期）。粤芯四期建成后，公司产能合计将达到12万片/月。业绩方面，2023年、2024年、2025年，公司营收分别为10.44亿元、16.81亿元、25.82亿元，2023-2025年均复合增长率为57.30%；归母净利润分别为-19.17亿元、-22.53亿元、-23.46亿元。公司预计未来产销规模将持续提升，长期盈利能力将得到有效改善。粤芯半导体此次预计募资75亿元。本次募集资金投向聚焦公司主业，包括12英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）、特色工艺技术平台研发项目和补充流动资金。（来源：中国证券报）

4 风险提示

中美科技摩擦加剧；AI应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳福田区深南大道 2007 号金地中心

广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场